

Buse de dessoudage 6,8 x 10,2 mm pour SOIC 14 et 16 - Oki H-S16

Réf. article WL27140

Fabricant Oki

Buse de dessoudage de 6,8 x 10,2 mm de dimension intérieure pour boîtiers SOIC à 14 et 16 broches sur le système à air chaud HCT-900. Elle enveloppe le composant et chauffe toutes les broches simultanément, ce qui permet de le retirer sans contraindre les pastilles. Changement sans outil sur la tête à air chaud.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Un boîtier SOIC ne se retire proprement que si ses deux rangées de broches montent en température en même temps. La H-S16 est une buse de dessoudage de 6,8 x 10,2 mm de dimension intérieure, dédiée aux SOIC 14 et SOIC 16 sur HCT-900.

AVANTAGES

- Dimension intérieure de 6,8 x 10,2 mm, ajustée aux boîtiers SOIC à 14 et 16 broches
- Forme enveloppante chauffant les deux rangées de broches en même temps, temps de maintien réduit
- Flux d'air chaud concentré préservant les composants voisins sur la carte
- Changement sans outil sur la tête à air chaud, temps de préparation réduits

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL27140
Modèle	H-S16
Fabricant	OKI
Référence fabricant	H-S16
Dimension intérieure	6,8 x 10,2 mm
Composant	SOIC 14, SOIC 16

Système	HCT-900
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Retrait et remplacement de composants SOIC 14 et SOIC 16 en réparation électronique, retouche et prototypage.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec le système de dessoudage à air chaud Oki HCT-900. Contenu de la livraison : une buse de dessoudage H-S16.